

卓上CMP実験機 BC-15

Kemet



本機は、CMP 部材開発から、部材スクリーニングおよびデバイス開発にと幅広くご活用いただける装置構成となっております。

諸元	
定盤径	15インチ(φ380mm)
定盤回転数	5～100RPM
研磨ヘッド径	Φ180mm
研磨ヘッド回転数	5～95RPM ※1
最大加工物径	φ152mm(6インチウェハー)
研磨ヘッド加圧機構	エアシリンダー
研磨ヘッド最大加圧	25kgf ※2
装置重量	約135kg
装置寸法(mm)	D600xW850xH800
電源	三相 220V

※1、※2 最大値は保証値ではなく、加工物や材料の加工負荷によります。